

3 证券代码：688521

证券简称：芯原股份

芯原微电子（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称	<u>2025年8月1日</u> Neuberger Berman、UG Investment、博时基金、淡水泉投资、工银安盛资管、建信基金、民生加银基金、诺安基金、太平基金、中银基金等
时间	2025年8月1日
调研方式	线上会议
公司接待人员姓名	公司董事长兼总裁：WAYNE WEI-MING DAI（戴伟民） 公司董事、董事会秘书、人事行政高级副总裁：石雯丽
投资者关系活动主要内容介绍	
公司介绍	<p>芯原是一家依托自主半导体 IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体 IP 授权服务的企业。</p> <p>公司拥有自主可控的图形处理器 IP（GPU IP）、神经网络处理器 IP（NPU IP）、视频处理器 IP（VPU IP）、数字信号处理器 IP（DSP IP）、图像信号处理器 IP（ISP IP）和显示处理器 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,600 多个数模混合 IP 和射频 IP。</p>

基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR 眼镜等实时在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研究和产业化。

基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nmFinFET 和 28nm/22nmFD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。此外，根据 IPnest 在 2024 年 5 月的统计，2023 年，芯原半导体 IP 授权业务市场占有率达到中国第一，全球第八；2023 年，芯原的知识产权授权使用费收入排名全球第六。根据 IPnest 的 IP 分类和各企业公开信息，芯原 IP 种类在全球排名前十的 IP 企业中排名前二。

根据公司《2025 年第二季度经营情况的自愿性披露公告》，2025 年第二季度，公司预计实现营业收入约 5.84 亿元，环比增长 49.90%，主要由知识产权授权使用费收入及量产业务收入增长所带动。具体而言，公司预计 2025 年第二季度实现知识产权授权使用费收入 1.87 亿元，环比增长 99.63%，同比增长 16.97%；预计 2025 年第二季度实现量产业务收入 2.61 亿元，环比增长 79.01%，同比增长 11.65%。预计公司 2025 年第

	<p>二季度盈利能力持续改善，单季度亏损环比大幅收窄。</p> <p>预计截至 2025 年第二季度末，公司在手订单金额为 30.25 亿元，在手订单已连续七个季度保持高位，较 2025 年第一季度末增长 23.17%，再创公司历史新高。2025 年第二季度末在手订单中，一站式芯片定制业务在手订单占比近 90%，随着公司芯片设计业务订单增加，预计未来公司会将更多研发资源投入客户项目，研发投入占比呈下降趋势。2025 年第二季度末在手订单中预计一年内转化的比例约为 81%，为公司未来营业收入增长提供了有力的保障。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2025 年半年度报告为准。</p>
交流问答	<p>问题：请问公司半导体 IP 授权业务和芯片定制服务如何实现相互赋能？</p> <p>回复：公司的一站式芯片定制服务和 IP 授权业务存在很强的协同性。公司在为客户提供一站式芯片定制业务的过程中，IP 的选型很大程度上决定了芯片的性能和功耗，因此对于客户而言，在一站式芯片定制业务中使用芯原自有 IP 在成本和设计效率等方面更具优势；公司在为客户提供半导体 IP 授权服务的过程中，优质的 IP 和服务逐步受到客户认可。当客户出现新的芯片定制需求时，基于已有合作基础，会优先考虑采用芯原的一站式芯片定制服务。</p> <p>问题：请问公司在智驾领域有哪些技术布局？</p> <p>回复：近年来，公司聚焦快速增长的汽车电子领域，芯片设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证，可从芯片和 IP 的设计实现、软件开发等方面，为全球客户满足功能安全要求的车载芯片提供一站式定制服务；此外，芯原还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程，以及基于该平台的 ADAS 功能安全方案，并搭建了完整的自动驾驶软件平台框架。</p>

基于上述技术布局，芯原已经积累了为汽车厂商设计高性能车规 ADAS 芯片的相关经验，例如为某知名新能源汽车厂商提供基于 5nm 车规工艺制程的自动驾驶芯片定制服务，其中集成了芯原的多个半导体 IP，并符合 ISO 26262 功能安全标准，性能全球领先。目前芯原正在与一系列汽车领域的关键客户进行深入合作，并积极推进智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发，以在智慧出行领域取得更好的发展机会。

问题：根据公司披露的在手订单和收入情况，公司第二季度新签订单应该已经超过十亿。请问主要是哪些方面的客户项目带来的增量？

回复：公司不断开拓增量市场和具有发展潜力的新兴市场，受 AI 算力等相关领域需求带动，公司订单快速增长，预计截至 2025 年二季度末，公司在手订单金额为 30.25 亿元，较 2025 年第一季度末增长 23.17%，再创公司历史新高，其中近 90% 的在手订单来自于公司一站式芯片定制业务，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2025 年半年度报告为准。

问题：请问公司在视频编解码领域的客户情况如何？

回复：互联网视频相关应用市场日益增长，如 4K 高清直播、在线会议、云游戏等应用，都需要在数据中心进行高密集度的视频解码和编码。芯原的数据中心视频转码平台可以大幅度提高数据中心的视频处理能力，并降低整体功耗和成本。目前，芯原的视频处理器 IP 技术已被全球前 20 大云平台解决方案提供商中的 12 家，中国前 5 大互联网提供商中的 3 家，以及 2024 年中国造车新势力 Top 8 榜单中 5 家所采用，体现公司在服务器、数据中心和汽车市场占据了有利地位。

此外，芯原数据中心视频转码加速解决方案可以为客户提供基于芯原自有 IP 的高性能视频转码芯片和开源软件一体化解决方案，广泛应用于视频加速卡、流媒体及视频点播、数据中心服务器及安全监控视频系

统等，为客户提供高性能视频处理的同时，极大地降低整体功耗和成本。目前，基于芯原 IP 的第二代视频转码平台一站式芯片定制项目（包括软硬件协同验证）已基本完成，该平台在原有的技术基础上将不同格式视频转码能力增强到 8K，增加了对 AV1 格式的支持，并新增了 AI 处理能力，此外，还增加了高性能的多核 RISC-V CPU 和硬件的加密引擎。

问题：请问公司在 Chiplet 领域的技术布局有哪些？

回复：芯原拥有丰富的处理器 IP，以及领先的芯片设计能力，加上我们与全球主流的封装测试厂商、芯片制造厂商都建立了长久的合作关系，近几年来一直在致力于 Chiplet 技术和产业的推进，通过“IP 芯片化，IP as a Chiplet”和“芯片平台化，Chiplet as a Platform”，来促进 Chiplet 的产业化。

目前，芯原已帮助客户设计了基于 Chiplet 架构的 Chromebook 芯片，采用了 SiP (System in Package) 先进封装技术，将高性能 SoC 和多颗 IPM 内存合封；已帮助客户的 AIGC 芯片设计了 2.5D CoWoS 封装；已设计研发了针对 Die to Die 连接的 UCIe 物理层接口，相关测试芯片已流片，即将返回进行封装和测试；已和 Chiplet 芯片解决方案的行业领导者合作，为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款芯原自有处理器 IP，帮助其部署基于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片，该芯片面向数据中心、高性能计算、汽车等应用领域。此外，为了应对先进封装技术可能出现的供应和成本等问题，芯原已针对新一代面板级封装 (Panel level package) 技术进行了先行设计开发，为接下来的规模量产做好了准备。本土封装厂也正在积极布局该封装技术，芯原将与之携手，共同打造更具成本效益且供应安全的先进封装解决方案。